US/A3-2/P

# Declaration and Power of Attorney For Patent Application

## 特許出願宜言書及び委任状

# **Japanese Language Declaration**

# 日本語宜言書

As a below named inventor, I hereby declare that:

stated next to my name.

My residence, mailing address and citizenship are as

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宜言します。

私の住所、郵便の宛先、国籍は下配の私の氏名の後に配 載された通りです。

ある

ことを認めます。

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出 願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明 者(下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発 明者(下記の名称が複数の場合)であると信じています。	I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled.
薄膜磁気ヘッド及びその製造方法	THIN FILM MAGNETIC HEAD AND MANUFACTURING METHOD THEREOF
上記発明の明細書は、	the specification of which
□ 本書に添付されています。	is attached hereto.
□ 月日に提出され、米国出願番号または特	☑ was filed on September 30, 2003
許協定条約国際出願番号を	as United States Application Number or PCT International Application Number
とし、	10/673,172 and was amended on
(該当する場合) に訂正されました。	(if applicable)
Kは、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、 内容を理解していることをここに表明します。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
私は、連邦規則法典第 37 編第 1 条 56 項に定義されるとまり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務カある	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56.

## Japanese Language Declaration (日本語官言書)

私は、米国法典第 35 編 119 条(a) - (d)項又は 365 条 (b 項

に基づき下配の、米国以外の国の少なくとも一ヵ国を指定している特許協力条約 365(a)項に基づく国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出顧の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, § 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or § 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Application(s) 外国での先行出顧	,		Priority Claimed 優先権主張
(Number) (番号)	(Country) (国名)	(Day/Month/Year Filed) (出顧年月日)	□ □ Yes No はい いいえ
(Number) (番号)	(Country) (国名)	(Day/Month/Year Filed) (出顧年月日)	□ □ Yes No はい いいえ
私は、第 35 編米国法典 119 条 国 特許出願規定に記載された権利		I hereby claim the benefit under Code, §119(e) of any United application(s) listed below.	
(Application No.) (出顧番号)	(Filing Date) (出顧日)	(Application No.) (出顧番号)	(Filing Date) (出顧日)
私は、下記の米国法典第 35 編 国 特許出願に配載された権利、又 力条約 365 条 (c) に基づくれ た、 本出願の各請求範囲の内容が 項 又は特許協力条約で規定された に開示されていない限り、その 本出願書の日本国内または特許 間中に入手された、連邦規則 義さ れた特許資格の有無に関する重 あることを認識しています。	は米国を指定している特許協 権利をここに主張します。ま 米国法典第 35 編 112 条第 方法で先行する米国特許出顧 先行米国出願書提出日以降で 協力条約国際提出日までの期 法典第 37 編 1 条 56 項で反	I hereby claim the benefit under Code, §120 of any United States a of any PCT International application States, listed below and, insofar as each of the claims of this application prior United States or PCT Internationanner provided by the first paragrage States Code, §112, I acknowledge information which is material to partitle 37, Code of Federal Regulation available between the filing date of the national or PCT International application.	pplication(s), or \$365(c) designating the United s the subject matter of is not disclosed in the tional application in the raph of Title 35, United the duty to disclose tentability as defined in its, \$1.56 which became the prior application and
(Application No.) (出顧番号)	(Filing Date) (出顧日)	(Status: Patented, Pending (現況:特許許可済、係属	
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出顧日)	(Status: Patented, Pending (現況:特許許可済、係属	

#### Japanese Language Declaration (日本語宜言書)

私は、私自身の知識に基づいて本宜言書中で私が行なう表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基づく表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、もしくはその面

方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽 の声明を行なえば、出願した、又は既に許可された特許の有 効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宜 暫を致します。

委任状:私は下配の発明者として、本出願に関する一切の手続きを米特許商標局に対して遂行する弁理士または代理人として、下記の者を指名いたします。

(弁護士、または代理人の指名及び登録番号を明記の こと) I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith: (list name and registration number)



書類送付先

Send Correspondence to:



022850

直接電話連絡先:(名前及び電話番号)

Direct Telephone calls to: (name and telephone number)

(703) 413-3000

単独発明者または第 1の共同 佐々木 芳高	発明者の氏名	Full name of sole or first inventor Yoshitaka SASAKI
発明者の署名	日付	Inventor's signature Date  Dec. 18, 2003
住所		Residence c/o Headway Technologies, Inc., 678 S. Hillview Dr. Milpitas, CA 95035, U. S. A.
国籍		Citizenship JAPAN
郵便の宛先		Mailing Address c/o Headway Technologies, Inc., 678 S. Hillview Dr. Milpitas, CA 95035, U. S. A.

# Japanese Language Declaration (日本語宜言書)

第 2の共同発明者の氏名		Full name of second joint inventor, If any
上釜 健宏		Takehiro KAMIGAMA
第 2の共同発明者の署名	日付	Second inventor's signature Date
		Dec. 18,2003
住所		Residence c/o SAE Magnetics (H.K.) Ltd., SAE Tower, 38-42, Kwai Fun Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
国籍		Citizenship JAPAN
郵便の宛先		Mailing Address c/o SAE Magnetics (H.K.) Ltd., SAE Tower, 38-42, Kwai Fun Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
第 3の共同発明者の氏名		Full name of third joint inventor, If any
伊藤 浩幸		Hiroyuki ITOH
第 3の共同発明者の署名	日付	Third inventor's signature Date  Dec. /8, 2003
住所		Residence c/o Headway Technologies, Inc., 678 S. Hillview Dr. Milpitas CA 95035, U. S. A.
国籍		Citizenship JAPAN
郵便の宛先		Mailing Address c/o Headway Technologies, Inc., 678 S. Hillview Dr. Milpitas CA 95035, U. S. A.